好上好 20260902

2026H1 机器人与端侧 AI 业务爆发，平台型分销商国产替代加速

摘要

- 2026H1 营收 80 亿元，存储业务占比 20%-30%，非消费电子领域（工业、机器人、汽车、数据中心）同比增速均超 20%-30%。
- 机器人业务已单列为核心板块，2026 年订单显著增加，部分头部客户订单达万台级；若计入清洁机器人，该板块营收占比接近 10%。
- 端侧 AI 领域代理星辰、恒玄等产品，AI 眼镜已切入行业前十头部客户；机器人方案新增压电散热技术，可使关节芯片满载降温 20℃。
- 汽车电子聚焦座舱、智驾及三电系统，深度绑定东软、华阳等 Tier1 及吉利、长安等车企；2025 年布局的 MTK 掌锐产品线增长显著。
- 服务器业务构建“算力+存储+电源+连接”矩阵，通过收购宝汇芯微获取 MPS 电源芯片，新签新拓微布局 PCIe 高速接口芯片。
- 国产化替代加速，公司代理的摩尔线程、后摩、爱芯元智等“大小脑”方案已在多客户进入小批量阶段，替代英伟达及 X86 平台。
- 行业集中度向头部平台型分销商靠拢，公司通过技术增值服务提升客户粘性，并计划通过并购互补标的实现规模扩张。

Q&A

2026 年上半年公司营收同比增长 90.18%，请问其中存储业务的价格和销量驱动因素分别贡献了多少？剔除存储品类后，其他产品线的营收增速情况如何？

2026 年上半年，存储业务的业绩占公司总营收的比重约为 20%至 30%，相较于之前约 10%的占比有显著增长。这一增长部分得益于存储市场的整体行情，尤其是在 AI 服务器和端侧 AI 存储领域的布局获得了收益。非存储业务部分，端侧 AI SoC 以及机器人行业相关产品线也实现了较大幅度的增长。

请问 2026 年上半年端侧 AI SoC 业务的营收规模和同比增速如何？同时，在 AI 眼镜和机器人等应用场景的客户导入进展及订单能见度情况是怎样的？

公司在端侧 AI SoC 领域主要代理星辰半导体和恒玄科技的产品线，2026 年上半年该业务实现了强劲增长。增长动力一方面源于市场需求的提升，另一方面也受到供应链紧张导致的芯片价格上涨的正面影响。 在具体应用场景方面： AI 眼镜领域，公司已与行业排名前十的头部客户进行直接交易。目前该市场整体仍处于量产爬坡阶段，但客户对未来前景持乐观态度，行业正处于品牌爆发期，可能将经历市场洗牌。 机器人领域，自 2023 年底至 2024 年以来，公司一直将其作为重点布局方向，并已与行业内知名的头部企业、上市公司及未上市的品牌客户持续进行交易。从 2024 年至 2026 年，技术迭代迅速，2026 年订单落地情况有明显增加，部分头部机器人厂商的订单量已达到万台级别。

公司技术方案团队在端侧 AI 和机器人领域的方案开发有哪些新进展？从方案设计到客户实现批量采购的转换周期通常是多长时间？

公司作为技术型分销商，拥有约 100 多人的工程师团队，在端侧 AI 领域具备传统优势。除了能为影像、视频、音频相关的端侧产品提供完整的交钥匙解决方案外，公司还针对新兴领域进行了专门布局。 在 AI 眼镜方面，公司为杭州某家在上海人工智能大会上发布新产品的客户提供了影像视觉 ISP 处理部分的技术支持与整体方案。 在机器人领域，公司此前已发布一套基于嵌入式 MCU 加氮化镓的小关节整体解决方案。近期，该方案得到更新，在端侧关节方案中加入了最新的压电散热技术。实测数据显示，在满负载情况下，该技术可将关节芯片温度从 70 多摄氏度有效降低约 20 摄氏度。公司计划在 2026 年 9 月底前正式发布关于此最新方案的文章并向客户端推广。

请问公司机器人业务的营收占比及内部产品结构是怎样的？对于 2026 年全年机器人业务的营收增速有何预期？

机器人业务尚处于市场培育及早期爆发阶段，因此在 2026 年上半年近 80 亿元的总营收中，其占比相对不高。目前，头部客户已进入量产状态，订单规模达到万台级别，但分解到公司层面的业绩贡献仍然较小。产品线方面，涵盖了“大脑”（端侧 SOC，如摩尔线程、后摩、爱芯元智的产品）、“小脑”、存储、嵌入式 SoC、MCU 以及功率器件等，整体营收规模约为千万元级别。值得注意的是，公司的机器人业务范畴广泛，不仅包括具身机器人，还覆盖了消费级人形机器人、协作工业机器人、四足机器人以及清洁机器人（如扫地、泳池、割草机器人等）。如果将已实现大规模量产的清洁机器人业务计算在内，机器人板块的整体营收占比可达到百分之几，接近两位数。 从战略层面看，机器人业务已被公司单列为未来一个非常重要的板块，其潜力与现有的消费电子、汽车电子、工业新能源等板块相当。目前，在机器人“大小脑”方案上，公司代理的国产化产品线（如摩尔线程、后摩、爱芯元智）已在众多客户中进入小批量阶段，用以替代原有的英伟达及 X86 平台方案。在机器关节部分，围绕兆威机电等 MCU 产品线也已获得相

当数量的批量订单。 关于非消费电子领域的整体增长情况，包括工业能源、机器人、汽车电子、通讯与计算（数据中心）等重点布局领域，同比均实现了显著增长，增幅普遍在两位数以上，部分甚至达到 20%至 30%。与此同时，消费电子业务的绝对值仍在增长，但其在公司总营收中的占比呈下降趋势。

公司在汽车电子领域的主要客户类型、核心产品线布局是怎样的？相关车规级产品的认证周期和客户粘性如何？

公司在汽车电子领域设有专门的市场推广团队，并投入了较多人员。核心产品线布局较为齐全，主要围绕智能模组，配套提供智驾系统、电子后视镜、智能导航辅助系统所需的存储、MCU、功率器件以及整套电源类芯片。 市场方向上，主要聚焦三大领域：智能座舱系统、辅助驾驶系统以及车身三电系统（电池、电控、电机）。客户资源覆盖了众多 Tier 1 厂商和部分车企。主要的 Tier 1 客户包括东软、华阳、联友、博泰、诺博等。同时，也与吉利、长安等车企有直接合作。特别是在 2025 年布局的 MTK 旗下主攻智能座舱的产品线“掌锐”，业务取得了非常显著的增长。 在客户粘性方面，随着汽车电子行业的蓬勃发展与整合，公司凭借平台型优势，在资金、技术增值服务（如提供核心板）以及产品线配套的全面性上，与 Tier 1 厂商及车企的合作愈发紧密。这种全面的服务能力使得公司的客户粘性远高于传统的渠道型经销商，并且在行业发展过程中持续增强。

关于控股子公司宝汇芯微，其在 2026 年上半年的营收和净利润完成情况如何？业绩承诺期内的累计完成进度是否达标？

宝汇芯微的第一个业绩考核期为 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。在此期间，尽管面临一些困难，但团队最终完成了设定的 1,000 万元业绩目标。基于此，公司已按照既定计划，并依据会计师事务所出具的审计报告，完成了对其 19%股权的收购。从业绩达成和团队磨合两个维度来看，此次收购取得了良好的阶段性成果。

在当前涨价环境下，消费类市场的客户集中度是否有所提升？公司的账期和库存政策有无相应变化，以及下游客户是否存在延迟提货或削减订单的情况？

2026 年以来，消费类市场的环境变化剧烈，订单确实有向头部优质品牌客户集中的趋势。在从电容、PCB 板、IC 元器件到 SoC、存储等电子料及包材全面涨价的背景下，对消费类企业的经营成本和周转能力构成了巨大压力，这也考验了头部客户的经营健康度。公司在消费类市场经营超过 20 年，服务的客户基本为各细分行业的头部企业，订单向这些头部客户集中的情况已经出现。至于账期和库存责任，目前没有特别明显的变化。 从 2026 年上半年来看，尚未出现大规模延迟提货或削减订单的情况。但部分中小客户在涨价后，对其能否支撑成本以维持终端产品销售产生了犹豫和观望，其订单消化能力可能存在不确定性。这类品牌溢价能力不足、成本难以支撑的中小客户，未来不排除会出现延迟提货或削减订单的可能。然而，就公司目前服务的细分行业头部客户而言，上半年并未观察到

此类现象。

鼎瑞星的高压继电器和薄膜电容器在储能及充电领域的客户渗透率如何？

高压继电器的客户渗透率很高，主要与汽车电子领域配套。特别是在高压继电器方面，比亚迪是行业龙头，其技术指标已超越国外同类产品，在部分高端产品上甚至大幅领先。无论是在充电相关行业，还是与国际及国内头部企业的合作中，该产品在价格和市场占有率上均有良好表现。

公司在 2026 年上半年的存货余额及账龄结构是怎样的？与 2025 年年末相比，存储类产品的存货占比和库龄分布有何变化？

公司 2026 年上半年的库存结构保持大致稳定，没有出现严重的呆滞库存情形。在存货结构中，存储类产品的库存占比较少。由于存储业务占公司整体业绩的比重约为 20%至 30%，相应的库存水平也大致在此范围。目前，整体存货周转保持在良好水平，存货周转天数在同行业中处于前列。

在汽车、机器人、工业及 AI 领域的客户中，采用公司整套方案的客户比例大约是多少？整套方案销售的毛利率是否会高于单一器件销售？

作为技术型分销商，公司在技术方案上投入很大。在中小客户端，采用整套解决方案的比例较高。对于研发实力和技术领先度较强的中大型客户，公司更多扮演协作者的角色，向其提供具有优势和性价比的产品。在这种合作模式下，中大型客户在一些小器件上有更高的选择权，而核心的 SoC、存储等器件则会直接从公司采购。因此，公司并未对采用整套方案的客户比例进行过详细拆分。

如何看待分销行业的长期竞争格局？中小分销商的逐步出清将对公司的客户拓展和供应商地位产生何种影响？

分销行业的格局演变与消费类市场客户集中度的提升趋势类似。参考海外（如欧美、日韩）分销市场的发展经验，随着市场竞争的充分化和市场布局的完善，行业集中度会逐渐向头部企业靠拢。因此，中小分销商被并购、合并或整合的趋势将持续且更加明显。同时，大型平台型分销商向海外发展，与海外同行进行并购或合并的可能性也在增高。公司在近两年的尝试中，正在积蓄力量、积累经验，将顺应这一趋势逐步扩大规模，并会寻找与公司资源互补的标的，以实现规模的快速扩张。

公司的芯片定制业务是定位为未来的独立增长曲线，还是小规模的技术储备？

芯片定制业务是公司在积累了 20 多年分销行业经验后，向产业链上游进行的一次突破和尝试。通过这项业务，公司正在探索技术储备以及向上游发展的可能性，旨在更深度地参与芯片制造与设计环节，为未来向上游探索积累管理经验并加深

对芯片设计的理解。可以将其视为一种小规模的技术储备，也是为未来向上游探索所做的准备。

公司在服务器市场中的核心竞争力主要体现在哪些方面，是存储供货、算力芯片资源，还是完整的电源和连接方案？

公司在服务器市场的核心竞争力是多方面综合布局的结果，按重要性排序依次是：算力芯片、存储供货、核心电源管理芯片以及连接器件。为构建这些能力，公司进行了一系列布局。通过收购宝汇新威，公司获得了 MPS 产品线，掌握了从多相控制器到 Driver MOS 的服务器电源芯片，显著提升了在该领域的竞争力。2025 年，公司新签了新拓微产品线，布局了 PCIe 相关的桥接芯片、Retimer、Switch 等高速互联接口芯片。在算力芯片环节，公司已布局摩尔线程、爱芯元智、后摩、光宇以及紫光展锐等，覆盖了广泛的应用领域。在存储方面，公司引入了德明利，并结合原有的江波龙、兆易创新等产品线，形成了完善的布局。总体而言，公司围绕算力芯片，协同布局了高速连接、电源管理和存储，实现了多头并进、多线布局，为未来服务器业务的快速增长做好了储备。

